

Tech팀

이종욱 팀장

jwstar.lee@samsung.com

문준호 Senior Analyst

joonho.moon@samsung.com

정승호 Research Associate

seungho1.jeong@samsung.com

김경빈 Research Associate

kyoungbeen.kim@samsung.com



리서치센터 리포트
바로가기

Tech (OVERWEIGHT)

Computex 2026: 하반기 엔비디아의 역습에 주목

- 올해 Computex는 엔비디아도 에이전틱 AI를 위한 통합 솔루션, 새로운 CPU 및 PC를 다루며 AI의 온기가 GPU 너머로 확산되는 것이 보여진 점이 가장 큰 차이
- 최근 AI로 재평가 된 기업들이 많지만, 하반기 Vera-Rubin 플랫폼 출시와 함께 엔비디아의 사업 기회가 확장되며 기존 엔비디아 밸류체인에 대한 관심 재개 기대

WHAT'S THE STORY?

Computex 2026, 무엇이 어떻게 달랐나? 그간 엔비디아 GPU 밸류체인에만 이목이 집중되었다면, 올해는 GPU 중심이 아닌, 서버 체인 전반에 폭 넓게 관심 집중.

- **CPU:** 엔비디아 키노트를 관통하는 하나의 주제는 에이전틱 AI였고, 해당 맥락에서 차기 Vera CPU에 상당 시간을 할애. 과거 AI 서버 내 CPU가 GPU에 명령을 내리는 것에 그쳤다면, 이제는 KV cache 관리, SW 제어 등이 요구되고, orchestration, 데이터 접근, 보안 및 스토리지 등까지 역할 확대.
- **Connectivity:** AI의 병목은 '얼마나 빠르게 계산하는가'(Compute & Memory)에서 '더 많은 데이터를 얼마나 빠르고 많이 연결하는가'(Connectivity)로 이동. 이 과정에서 더 높은 대역폭과 더 넓은 전송거리를 구현하기 위해 copper에서 optical로의 전환은 결국 필연적. 젠슨 황은 마벨을 차기 1조달러 기업으로 전망했을 정도.
- **메모리:** 메모리 3사 모두 HBM 차세대 제품을 전면 배치. 특히 삼성전자는 차차세대 제품인 HBM5의 목업을 공개하며 공격적인 경쟁 참여 선언. SOCAMM의 고용량화 트렌드와 함께 RTX Spark, 로보트까지 수요 저변 확대를 확인. 최태원 SK 회장의 캐파 2배 확대 발언 등을 통해, 당사는 '28년까지 공급과잉 우려가 시기상조라고 판단.
- **CCL-기판:** Vera-Rubin의 Midplane 구조 변화와 SOCAMM2 채택에 따른 CCL 및 기판 TAM 확대 전망. AI 서버용 저손실 CCL을 공급 중인 두산과 SOCAMM용 모듈 PCB 및 MCP 기판을 공급하는 심텍의 수혜 가능.

투자 전략 - 하반기 엔비디아 밸류체인 관심 재개 기대: 올해는 AI의 온기가 확산되며, 인텔처럼 AI와는 거리가 멀었던 주식들이 outperform한 게 사실. 물론 AI 수혜주가 늘어났을 수는 있으나, 여전히 엔비디아와 메모리, TSMC 등 엔비디아 밸류체인이 AI 하드웨어 시장을 주도하고, 생태계 패권을 쥐고 있음. 하반기 Vera-Rubin 플랫폼 (CPU, LPX 등 포함)의 출시가 새로운 전환점. 이를 기점으로 엔비디아의 사업 기회가 확대될 것이며, 엔비디아가 가져올 새로운 파이도 기존 엔비디아 밸류체인이 함께 향유. 기존 엔비디아 밸류 체인에 대한 관심 재개 기대.

(다음 페이지에 계속)

Agentic AI가 초래한 변화: CPU의 역할 확대 (Feat. NVIDIA)

올해도 Computex의 주인공은 단연 엔비디아와 젠슨 황이었고, 젠슨 황은 또다시 AI의 전도사 역할을 해 주었다. 이번 키노트의 키워드는 에이전틱 시로, 에이전틱 시가 어떻게 데이터센터 환경을 변화시키고 이에 대응하는 엔비디아의 전략을 공유하는 시간이었다.

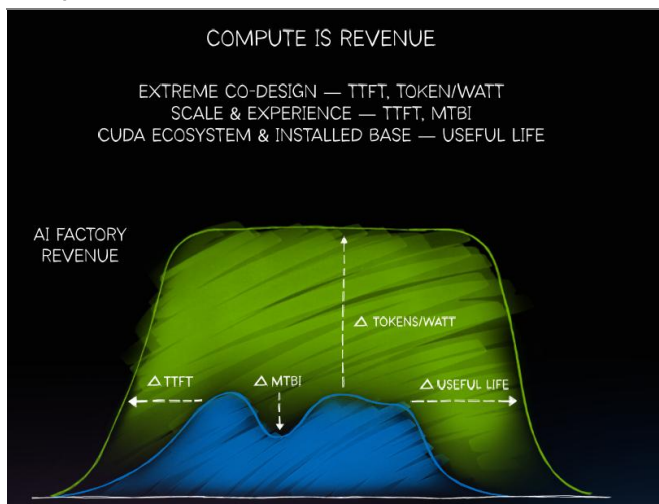
Compute = Revenue라는 공식은 엔비디아의 근간이다. AI 수익화의 핵심은 1) 시스템 구축 후 첫 토큰을 얼마나 빨리 생성하고, 2) 제한된 전력 내 토큰 생성량(throughput)을 최대화하고, 또 3) 구축된 시스템의 내용연수의 기간에 달려 있다. 엔비디아가 늘 강조하는 것은 시스템 구축 비용이 중요한 게 아니라, TCO (Total Cost of Ownership)이다. 비싸도 더 많은 토큰을 빠르게 생성하고, 또 해당 시스템을 오랜 시간 사용하는 것이 경쟁력이라는 것이다.

기존 LLM 시절의 데이터센터와 에이전틱 시 데이터센터는 작동 방식이 다르기에, 데이터센터 환경도 변화가 필요하다. LLM 시절의 CPU는 모든 연산을 담당할 GPU를 제어하는 데 그치지 않았다. 하지만 추론 과정이 심화되고, 또 에이전틱 시가 확산되면서 이는 GPU가 모든 것을 다루는 것은 일종의 비효율이 되었다. 그리고 비효율은 곧 토큰 생성량 저하, 즉 수익 감소로 귀결된다.

에이전틱 시는 자율적으로, 그리고 지속적으로 다양한 단계로 작동한다는 점에서 CPU의 역할이 확대된다. 목표가 설정되면 스스로 계획을 세우고, 실행하고, 데이터를 읽고, 톨을 호출하고, 검증 및 수정하는 여러 단계를 거친다. 이 모든 과정은 대규모 행렬연산에 특화된 GPU 보다는 빠른 순차연산에 특화된 CPU가 담당하는 몫이다. GPU의 역할 자체는 남아있지만 GPU가 전후로 수행할 작업 사이, 사이의 작업들 (orchestration layer)을 CPU가 담당하게 되는 것이다.

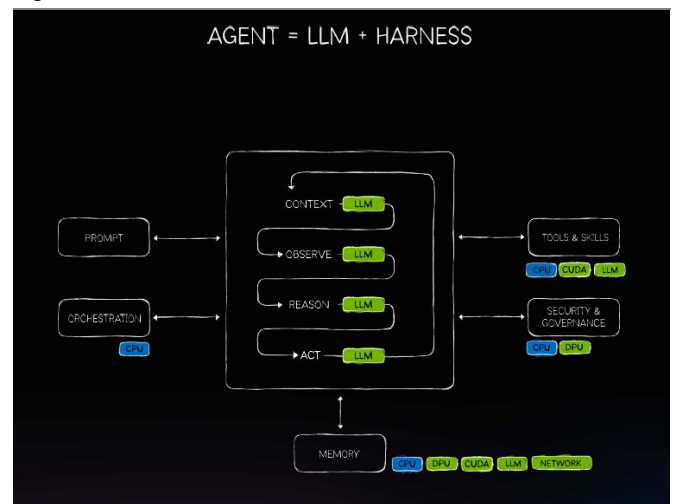
엔비디아는 에이전틱 시에 특화되어 설계된 차기 Vera CPU를 선보였다. Vera CPU는 88개의 Arm 기반 자체 코어로 구성되어 있고, x86 대비 코어당 대역폭이 3배, 전체 대역폭은 2배 더 높다. 정통 x86 CPU 대비 Python과 같은 작업에서 성능이 1.8배 우수함을 선보였다. Vera부터 CPU를 단독으로 판매하기 시작해서일까. 엔비디아가 작년까지는 다른 반도체 업체들과 경쟁이 아닌 공생, 그리고 생태계 개방을 강조했다면, 이번에는 다시 경쟁력을 강조하기 시작했다.

Compute = Revenue



자료: NVIDIA, 삼성증권

Agentic AI 역할 분담



자료: NVIDIA, 삼성증권

Vera CPU를 기준으로 하여 세 가지 랙 솔루션이 공개되었다. 첫 번째는 Vera-Rubin 랙으로, 기존의 Grace-Blackwell 시리즈를 승계하는 제품이다. 기존과 같이 대형 LLM 학습과 고성능 추론 등 GPU의 강력한 연산에 쓰이는 랙이다. 여기서의 CPU 역할은 이전처럼 GPU를 작동하는 데 그친다.

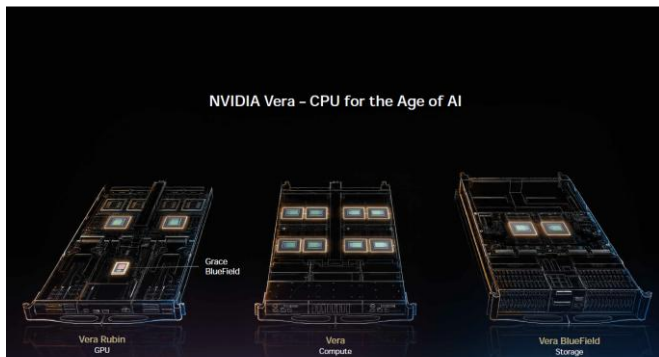
두번째 솔루션은 Vera Compute로 CPU가 메인인 되는, GPU가 부재한 CPU로만 구성된 랙이다. 상기 언급하였듯, 다양한 orchestration layer는 CPU 기반 작업을 요하므로, 이에 특화된 솔루션이라 생각할 수 있다. 세번째 솔루션은 Vera BlueField로, 스토리지에 특화되어 있다. 에이전틱 AI는 대량의 context를 반복적으로 읽고 쓰며, 이 과정에서 보안도 필요하다. 이에 CPU가 데이터 이동과 저장 및 보안 작업을 전문적으로 담당할 Bluefield DPU와 함께 구성된 랙이다.

너무 Vera CPU에만 관심이 집중되고, 또 CPU 경쟁력을 위주로 강조하여, 마치 GPU의 존재감이 줄어드는 것으로 해석될 수 있다. 그러나 이 모든 새로운 솔루션들은 궁극적으로는 GPU를 위함이다. GPU가 오로지 수익이 되는 토큰 생성에만 집중할 수 있도록, 역할을 효율적으로 분담하게 데이터센터 구축 환경이 변화하고, 이 과정에서 CPU의 역할과 중요도가 증가할 뿐이다.

그렇게 에이전틱 AI가 확산됨에 따라 CPU의 역할이 확대되고, 이 과정에서 엔비디아의 사업 기회가 빠르게 확대된다는 점이 핵심 포인트다. Vera-Rubin은 이미 양산에 돌입했으며 3분기부터 출하될 예정이다. Vera-Rubin과 함께 Vera CPU, Groq LPU, Bluefield 등 다양한 신제품도 출시를 앞두고 있다. 특히 Vera CPU의 경우 지난 컨퍼런스콜에서 이미 올해 Vera CPU 단독 매출액이 200억달러에 달할 것이라는 가이던스도 제시한 바 있다.

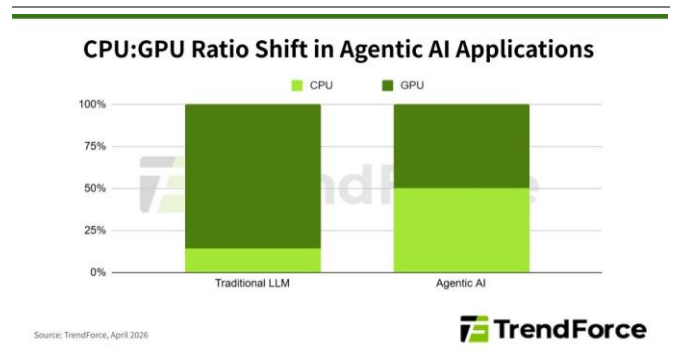
한편 젠슨 황은 에이전틱 AI와 함께 PC CPU 시장 진출도 본격화하여, 아직 On-device AI라는 목표도 여전히 유효함을 확인할 수 있었다. 젠슨 황은 마이크로소프트와 공동 개발한 AI 노트북 PC RTX Spark를 새로이 공개했다. 미디어텍과 공동 개발한 CPU N1 시리즈(Grace 코어 20개)가 탑재되고, Blackwell GPU와 128GB 메모리를 공유하게 된다. 젠슨 황은 개인/일반 소비자도 AI 에이전트를 활용하게 될 것이며, 기존의 PC 또한 혁신이 필요하다고 주장했다. 그간의 AI PC들처럼 CPU에 추가된 NPU 코어에만 의존하는 것이 아니라, AI 서버에서 GPU가 그랬듯 훨씬 더 강력한 로컬 컴퓨팅 파워가 필요함을 강조했다. 일전에 공개했던 워크스테이션 DGX Spark처럼 당장 시장 규모가 크지 않겠지만, AI가 PC(edge)로도 도입되려는 시도들이 지속되고 있다는 것에 의의가 있다고 생각한다.

Vera CPU의 세 가지 적용처



자료: NVIDIA, 삼성증권

CPU:GPU 비율 변화



자료: TrendForce, 삼성증권

AI 인프라의 세 번째 병목, Connectivity

한편 젠슨 황은 마벨의 Computex 키노트에 깜짝 출연하여, 마벨을 차기 1조 달러 기업으로 꼽았다. 그 핵심 배경은 AI 인프라의 성능 병목이 Compute와 Memory를 넘어 Connectivity로 이동하고 있기 때문이다. 지금까지 AI 경쟁은 GPU의 연산 성능, HBM의 대역폭 등을 중심으로 설명되어 왔다.

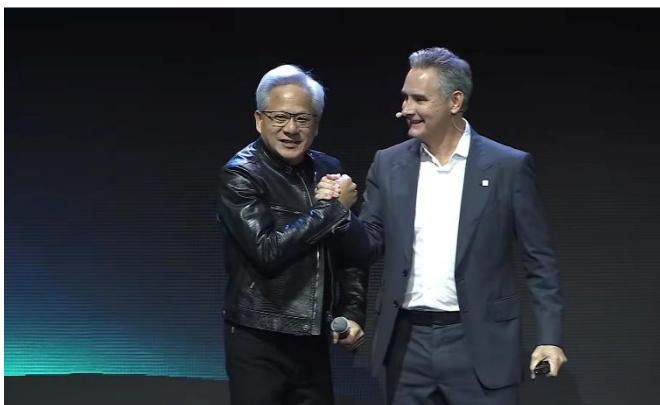
하지만 AI 모델이 추론, MoE, 에이전틱 AI로 진화하면서 단일 칩의 연산 성능보다 수만 개, 향후 수백만 개의 프로세서를 하나의 거대한 엔진처럼 묶는 능력이 더 강조되고 있다. 즉, AI 인프라의 병목이 '얼마나 빠르게 계산하는가'에서 '더 많은 데이터를 얼마나 빠르고 많이 연결하는가'로 이동하고 있다. 마벨은 이 변화 지점을 AI 인프라의 세번째 병목으로 정의했다.

Connectivity의 병목에서 핵심 과제는 Copper에서 Optical로의 전환이다. Copper는 대역폭이 높아질수록 전송 가능 거리가 짧아지는 물리적 한계에 도달하게 되며, Copper로 신호를 보낼 수 있는 최대 거리를 Copper Wall이라고 한다. 이 Copper Wall의 한계를 넘기 위해서 비싸지만 Optical을 사용하게 되는 것이다. 현재 통용되고 있는 200Gbps/lane 환경에서 Copper 케이블 길이는 약 2.5m 수준으로 제한되며, 400G로 전환되면 2m 높이의 랙 전체를 완전히 연결하기 어려워진다. 따라서 데이터센터 내부(Scale-out)에 위치하던 Copper Wall이 랙 내부(Scale-up)로 이동하게 된다.

마벨은 Copper Wall이 한 단계 더 짧은 거리 영역으로 이동할 때마다 필요한 연결 수가 약 10배씩 증가한다고 설명했다. 이에 따라 Optics가 랙 내부로 침투할 경우, optical 수요의 증가 폭은 부품의 전환 그 이상으로 확대될 수 있다. 이 과정에서의 핵심 기술인 CPO(Co-Packaged Optics)는 광 연결 부품을 칩 가까이 배치해 랙 내부까지 Optical을 끌어들이는 방식이며, 이는 곧 광 부품, 패키징, 검사, 후공정 등의 수요 확대를 가져온다. 따라서 Copper에서 Optical로의 전환은 단순한 부품 세대 교체가 아니라, 서플라이 체인의 증설과 생태계 확장을 요구하는 구조적 변화를 가져올 것으로 전망한다.

이 변화 속 마벨에 대한 인식도 ASIC과 네트워킹 시장 2인자에서, AI 인프라 내 데이터 이동을 담당하는 Connectivity Platform 강자로 변할 것으로 기대된다. 데이터센터 간 장거리 연결부터 패키지 내 chiplet 간의 연결까지, AI 인프라 내 모든 연결고리를 담당하고 있다는 차별화 포인트가 점점 부각될 것이다.

엔비디아 CEO 젠슨 황과 Marvell CEO 맷 머피



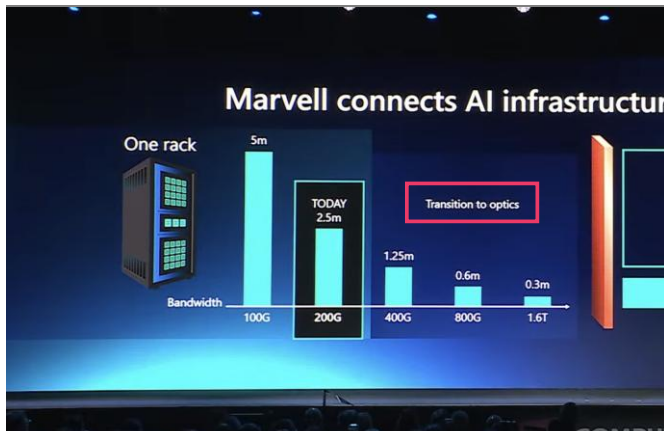
자료: Computex 2026

AI 인프라의 세 번째 병목, Connectivity



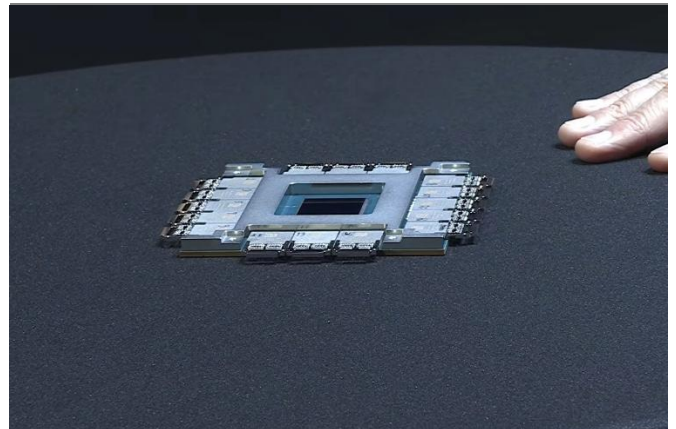
자료: Computex 2026

랙 전체를 연결할 수 없는 400G부터는 Optics 전환이 필요



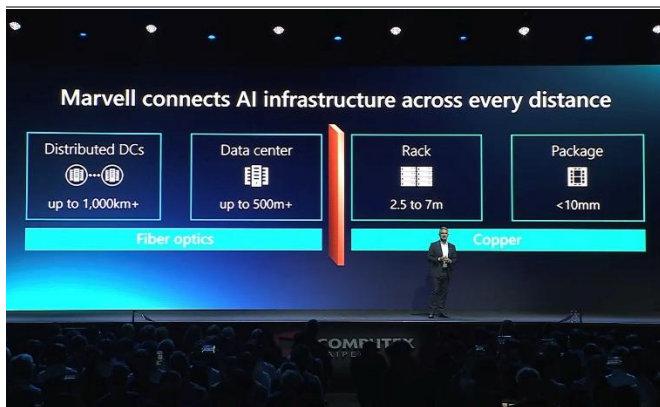
자료: Computex 2026

Marvell: 51.2T CPO 기반 switch



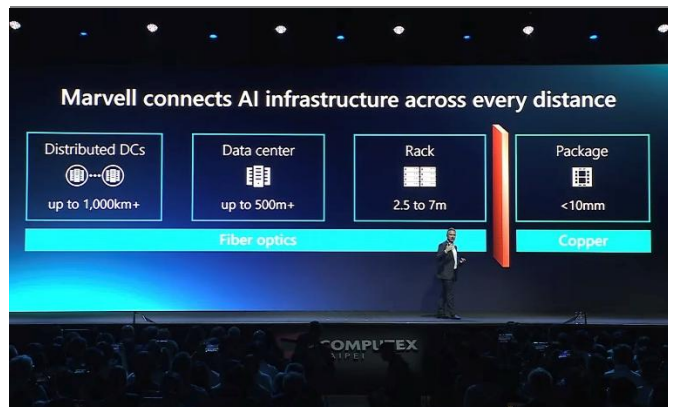
자료: Computex 2026

Scale-out 차원의 Copper Wall



자료: Computex 2026

Scale-up 차원의 Copper Wall



자료: Computex 2026

Marvell: 전송 거리별 핵심 기술

구간	거리	연결 목적	핵심 기술	현재 상황
데이터센터 간 Scale-across	수백 km	데이터센터 간 장거리 연결	Coherent modulation, Coherent DSP, Long-reach optics	800G 양산 출하 중, 올해말 1.6T 2nm 기반 제품 샘플링 예정
데이터센터 내부 Scale-out	수백 m	랙, spine, switch 연결	PAM4 DSP, TIA, Laser driver, Ethernet switching	작년 1.6T 3nm PAM4 램프업, 12.8T-51.2T switch 포트폴리오, 100T Ethernet switch 발표
랙 내부 Scale-up	수 m	GPU/XPU 간 연결	Electrical SerDes, Copper backplane, Scale-up switch	아직은 Copper의 영역. 200G SerDes 제 품 보유. 향후 400G SerDes 출시 예정
패키지 내부	수 mm	Chiplet die-to-die 연결	Die-to-die SerDes, 2.5D/3D packaging	복잡한 Chiplet 구조 설계 지원

자료: Marvell, 삼성증권

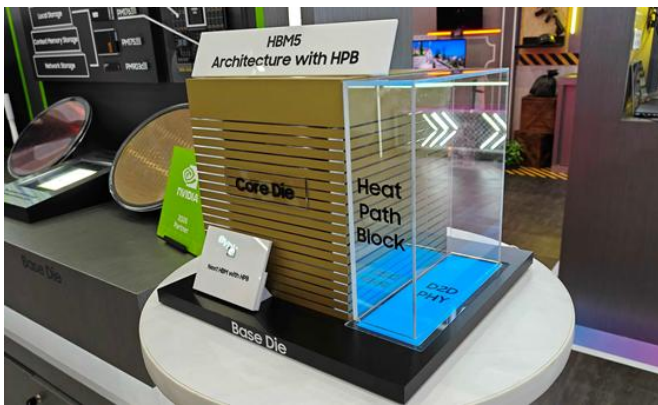
치열한 HBM 기술 경쟁 속 AI 메모리의 저변 확대

HBM 기술 경쟁은 이미 차차세대를 향해 달리고 있다. 삼성전자는 Computex에서 8세대 HBM5의 목업을 처음 공개했다. 2nm 베이스 다이, HPB(Heat Path Block) 열관리 아키텍처, 핀 스피드 최대 16Gbps과 총 대역폭 4TB/s, 12/16/20단 적층이 핵심 스펙이며 양산은 28년 이후로 전망된다. SK하이닉스는 HBM4E 웨이퍼 샘플을 처음 전시했고, 이번에 젠슨 황은 HBM4E에 'Please Make More'라는 의미심장한 코멘트를 남겼다. 마이크론도 HBM4 36GB 12H 제품을 전시하여 HBM 차기 경쟁의 참가를 알렸다.

엔비디아는 Computex에서 RTX Spark에 128GB SOCAMM을 탑재한다고 밝혔다. SK하이닉스는 192GB, 마이크론은 256GB SOCAMM2를 공개했다. 개인용 Agent 시대가 도래해 노트북 대신 개인용 HPC급 디바이스가 일상화된다면, 지금 PC 평균 12GB 콘텐츠는 128GB 이상으로 도약하게 된다. 이는 서버 DRAM의 주류가 저전력과 고집적 LPDDR로 이동하고 있음을, 그리고 그 수요처가 데이터센터를 넘어 로봇과 개인용 HPC까지 확장되고 있음을 의미한다.

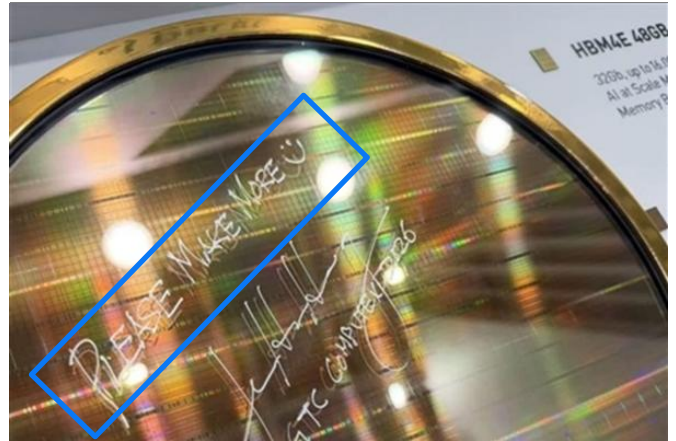
최태원 SK그룹 회장은 Computex에서 HBM 공급 부족이 30년까지 지속될 것이라 경고하며 웨이퍼 캐파를 5년 내 2배로 늘리겠다고 선언했다. 당사는 그 판단에 동의한다. 신규 팹들이 27년부터 공급에 기여하기 시작하더라도, 용인 클러스터 두 공장이 동시에 ramp-up되는 '29년 이후에야 업계 전체의 소위 New normal capex의 규모가 드러날 것이다. 그 부스트업을 '29년 이후로 미루고 있다는 것 자체가, 적어도 '28년까지 공급과잉 가능성이 낮다는 시그널로 읽힌다.

삼성전자가 전시한 HBM5 목업



자료: 언론종합

엔비디아가 전한 'Please Make More' 메시지



자료: 언론종합, 삼성증권

Midplane 도입으로 확장되는 CCL TAM

이번 Computex 2026에서는 연초 CES 2026에서 공개됐던 Vera Rubin 플랫폼이 다시 한번 강조됐다. Vera Rubin의 핵심 변화는 AI 서버의 연결 구조에 있다. 기존 Blackwell 플랫폼이 케이블 기반 아키텍처를 채택했다면, Vera Rubin은 중앙 Midplane PCB를 활용한 Cableless Compute Tray 구조를 도입한다.

Blackwell에서는 GPU, NIC, 스토리지 등을 다수의 케이블로 연결하는 방식을 사용했다. 그러나 GPU 수 증가와 NVLink 대역폭 확대에 따라 케이블 수량이 급격히 증가하면서 조립 복잡도와 신호 무결성 문제가 동시에 발생하기 시작했다. 실제로 젠슨 황은 Computex 기조 연설에서 Midplane 실물을 공개하며 이를 Vera Rubin 아키텍처의 핵심 변화 중 하나로 소개했다.

Midplane 구조 도입은 단순한 부품 변경이 아니다. 기존 케이블이 담당하던 신호 전송 기능을 대형 PCB가 대체하는 구조이기 때문이다. Midplane은 18개의 Compute tray와 9개의 NVLink Switch Tray를 연결하는 중앙 인터커넥트 연결을 수행한다. 따라서 Midplane에는 대규모 고속 신호가 집중되며, 이에 따라 PCB 면적 확대와 고다층화, 저손실 소재 채택 비중 증가가 예상된다.

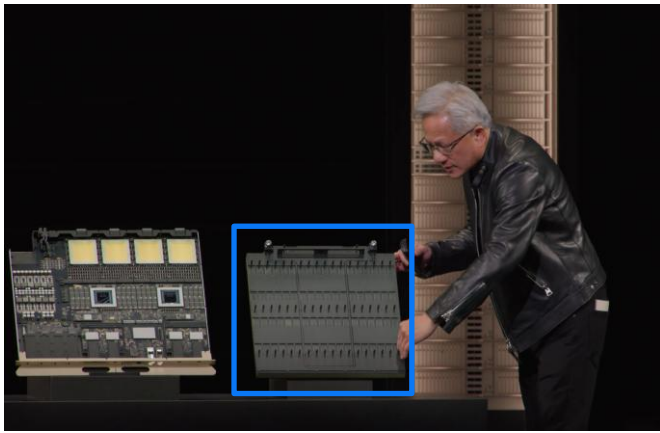
당사는 이러한 변화가 고성능 CCL 수요 증가로 이어질 것으로 전망한다. Vera Rubin은 Midplane이라는 신규 TAM이 추가되는 시작점이다. 따라서 Vera Rubin의 랙당 CCL 수요가 GB300 대비 약 1.5배 증가할 것으로 추정한다. 국내에서는 두산이 주요 수혜 업체가 될 가능성이 높다고 생각한다. 두산은 엔비디아 Compute Tray향 CCL 주요 벤더로, Vera Rubin에서도 기존 공급 관계를 기반으로 수혜가 이어질 가능성이 높다.

SOCAMM 시장이 열린다

Vera CPU의 가장 큰 변화는 SOCAMM2의 채택이다. 젠슨 황은 Vera CPU의 시장 규모를 "Multi-billion dollar business"라고 언급했다. 우리는 AI 서버 내 GPU 수 증가에 따라 데이터의 이동과 자원 할당을 담당하는 CPU의 오케스트레이션 역할이 더욱 중요해질 것으로 판단한다. 우리는 Vera CPU 확산 과정에서 SOCAMM향 기판 시장이 확장될 것으로 전망한다.

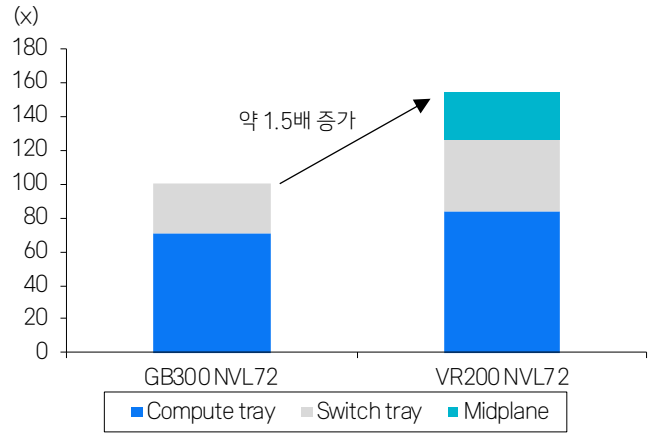
기판에서의 중요한 변화는 메모리 용량 증가보다 SOCAMM의 모듈화 구조에 있다. SOCAMM2는 다수의 LPDDR을 하나의 모듈 PCB 위에 실장하는 구조로 기존 대비 새로운 기판 수요를 창출한다. 또한 LPDDR 패키지 내부에는 고사양 MCP 기판이 함께 사용되는 만큼 모듈 PCB와 MCP 기판 수요가 동시에 증가한다. 국내에서는 심텍과 티엘비가 주요 수혜 업체가 될 것으로 생각한다. 특히 심텍은 메모리 3사 내 SOCAMM용 기판 공급망에서 모두 퍼스트벤더 지위를 확보하고 있어, SOCAMM 시장 점유율 과반 이상을 차지할 것으로 기대한다.

Vera Rubin부터 적용되는 Midplane 실물



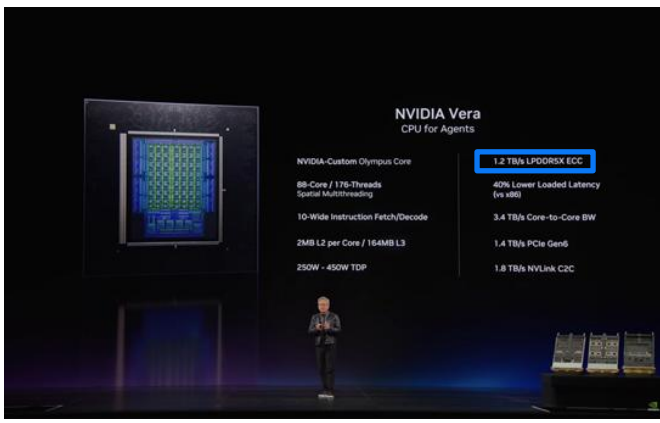
자료: NVIDIA, 삼성증권

Vera Rubin에서 증가하는 CCL 수요



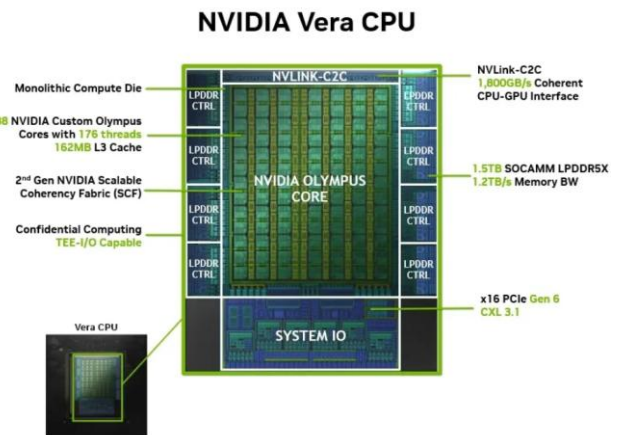
자료: 삼성증권 추정

Vera CPU 스펙 공개



자료: NVIDIA

Vera CPU 구조



자료: NVIDIA

투자 전략 - 하반기 엔비디아 밸류체인 관심 재개 기대

올해 메모리를 제외하고 보면, 글로벌 Tech 섹터에서 outperform한 종목들은 과거 AI와는 거리가 멀어 보였다가 비로소 AI의 온기가 전해지며 새로이 AI 수혜주로 평가받게 된 기업들이 많다.

대표 예시로는 인텔이 있다. GPU를 비롯한 AI 가속기 경쟁에서 뒤처지며 레거시/Non-AI 기업으로 평가 받았고, 전 세계 모든 자금이 다 AI로만 쏠리는 환경에서 성장에 대한 기대감이 클 리 없었다. 하지만 추론 수요 급증과 에이전틱 AI의 도입으로 인해 CPU가 AI 데이터센터의 핵심 반도체로 떠오르자, 인텔도 재평가 받게 된 것이다.

물론 기업에 대한 인식이 변화하면 부여 받는 valuation multiple이 달라지게 되고, 또 인식의 변화가 결국 변화한 전망에 근거할 것이기에 결국 가치(주가)는 순식간에 급증할 수 있다. AI cycle이 장기화되며, 인텔처럼 AI 수혜주는 점점 더 늘어나고 있고, 시장 관심도 new face에 쏠리는 게 사실이다.

그러나 이번 Computex에서도 느껴진 점은 여전히 AI 데이터센터의 방향을 주도하고, 생태계 패권을 쥐고 있는 것은 엔비디아와 메모리, TSMC 등 엔비디아 밸류체인이라는 점이다. 그리고 이때문에 하반기 Vera-Rubin 플랫폼의 출시가 한 번 더 전환점이 될 것으로 기대된다. 이전 세대와 달리, Vera-Rubin 아키텍처와 함께 엔비디아가 목표하는 시장은 더욱 확대되었고, 또 Vera CPU처럼 이미 빠르게 성과를 내고 있다. 하반기 엔비디아의 신제품 upside에 주목할 필요가 있다고 생각되며, 여전히 글로벌 반도체 섹터의 핵심 종목이라고 생각된다.

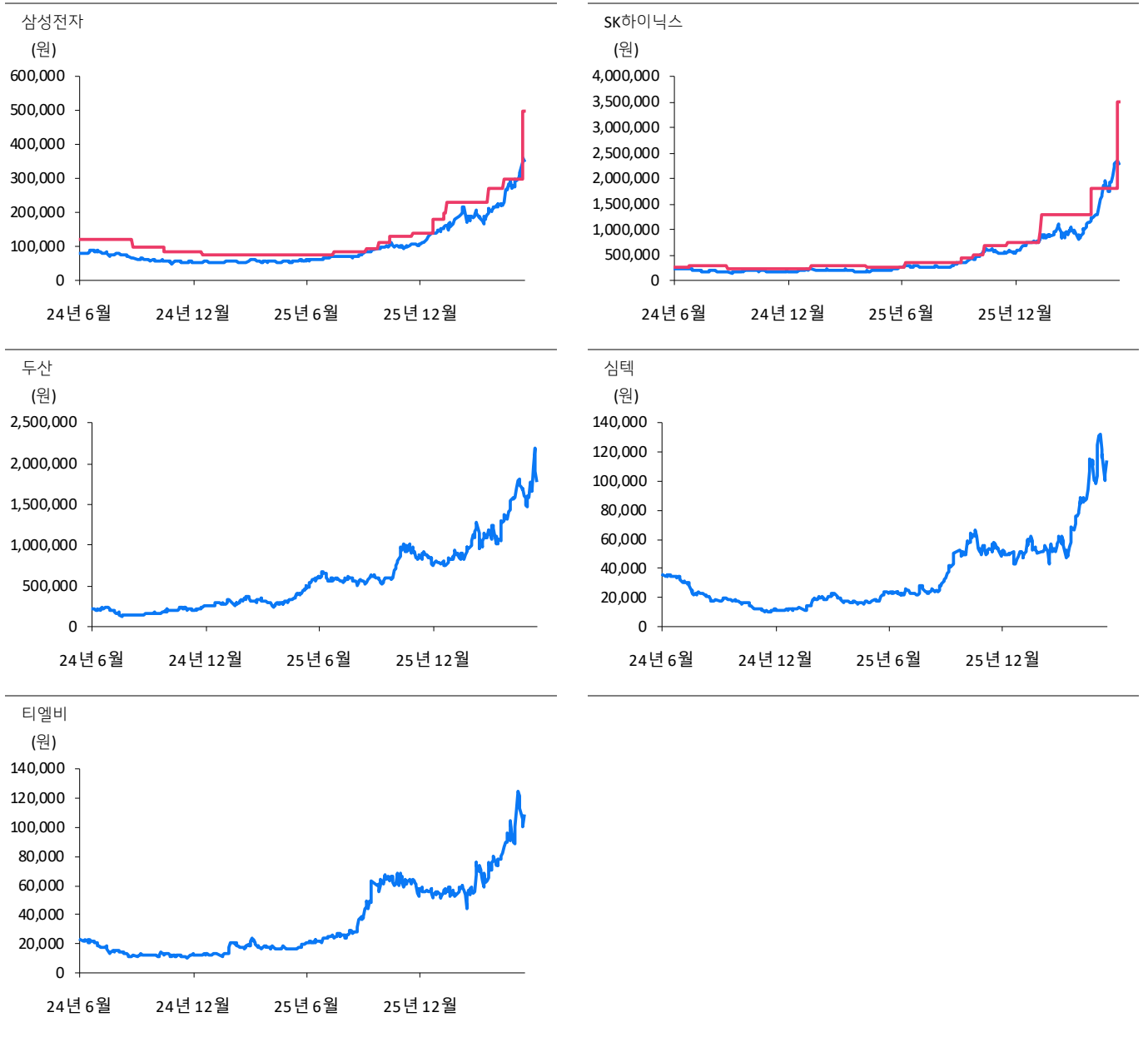
또한 엔비디아의 사업 기회가 확대되고, 엔비디아가 새로이 파이를 가져오는만큼 엔비디아의 밸류체인도 함께 수혜를 입는 것은 너무나도 당연한 수순이다. 1) 엔비디아의 거의 모든 제품의 생산과 advanced packaging을 담당할 TSMC와 2) Vera-Rubin으로의 세대 교체와 함께 HBM4로의 전환, SOCAMM 적용 등 고부가가치 제품 비중이 확대될 메모리 업체들(삼성전자, SK하이닉스, 마이크론)은 이번에도 한 번 더 수혜를 입을 것이다.

물론 이렇게 되면, 이들이 엔비디아로부터 수혜를 입듯, TSMC와 메모리 밸류체인으로도 투자 아이디어를 확대하려는 움직임도 있을 수 있다. 그러나 우선은 엔비디아 신제품 수혜를 가장 먼저, 그리고 직관적으로 향유할 TSMC와 메모리에 더 집중하고 싶다.

Compliance notice

- 당사는 2026년 6월 4일 현재 삼성전자와(과) 계열사 관계에 있습니다.
- 본 조사분석자료의 애널리스트는 2026년 6월 4일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 2026년 6월 4일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목을 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 본 조사분석자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
- 본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사분석자료는 기관투자가 등 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

2년간 목표주가 변경 추이



2026. 6. 5

최근 2년간 투자의견 및 목표주가 변경 (수정주가 기준)

삼성전자												
일 자	2024/5/28	9/12	11/1	2025/1/2	8/1	9/23	10/13	10/31	12/8	2026/1/9	1/27	1/30
투자의견	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY
TP (원)	120000	100000	83000	74000	85000	93000	110000	130000	140000	180000	200000	230000
과리율 (평균)	-34.45	-39.49	-33.92	-21.93	-15.05	-6.95	-10.64	-21.96	-16.54	-18.69	-19.23	-19.75
과리율 (최대or최소)	-26.83	-35.30	-29.28	-1.89	-1.76	1.51	-5.36	-14.54	0.71	-15.39	-18.80	-5.22
일 자	4/7	5/4	6/2									
투자의견	BUY	BUY	BUY									
TP (원)	270000	300000	500000									
과리율 (평균)	-20.25	-3.39										
과리율 (최대or최소)	-16.30	16.33										
SK하이닉스												
일 자	2024/4/8	7/12	9/12	2025/1/24	4/24	6/25	9/23	10/13	10/30	12/8	2026/1/27	1/30
투자의견	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY
TP (원)	250000	280000	240000	280000	250000	340000	430000	500000	700000	750000	950000	1300000
과리율 (평균)	-18.91	-34.15	-23.78	-30.26	-14.53	-17.52	-14.81	-3.33	-19.05	-11.48	-10.42	-26.68
과리율 (최대or최소)	-3.60	-16.79	-6.04	-21.96	11.40	3.82	-0.47	11.60	-11.43	2.27	-9.37	-10.31
일 자	4/21	6/2										
투자의견	BUY	BUY										
TP (원)	1800000	3500000										
과리율 (평균)	-3.42											
과리율 (최대or최소)	31.28											
두산												
일 자	2026/6/5											
투자의견	Not Rated											
TP (원)	n/a											
과리율 (평균)												
과리율 (최대or최소)												
심택												
일 자	2026/6/5											
투자의견	Not Rated											
TP (원)	n/a											
과리율 (평균)												
과리율 (최대or최소)												
티엘비												
일 자	2026/6/5											
투자의견	Not Rated											
TP (원)	n/a											
과리율 (평균)												
과리율 (최대or최소)												

투자기간 및 투자등급: 삼성증권은 기업 및 산업에 대한 투자등급을 아래와 같이 구분합니다.

*2023년 7월 27일부로 기업 투자 등급 기준 변경

기업

- BUY (매수)** 향후 12개월간 예상 절대수익률 15% 이상 그리고 업종 내 상대매력도가 평균 대비 높은 수준
- HOLD (중립)** 향후 12개월간 예상 절대수익률 -15%~15% 내외
- SELL (매도)** 향후 12개월간 예상 절대수익률 -15% 이하

산업

- OVERWEIGHT(비중확대)** 향후 12개월간 업종지수상승률이 시장수익률 대비 5% 이상 상승 예상
- NEUTRAL(중립)** 향후 12개월간 업종지수상승률이 시장수익률과 유사한 수준 (±5%) 예상
- UNDERWEIGHT(비중축소)** 향후 12개월간 업종지수상승률이 시장수익률 대비 5% 이상 하락 예상

최근 1년간 조사분석자료의 투자등급 비율 2026.03.31 기준

매수(85.2%)·중립(14.8%)·매도(0%)

삼성증권

삼성증권주식회사

서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)
Tel: 02 2020 8000 / www.samsungpop.com

삼성증권 Family Center: 1588 2323

고객 불편사항 접수: 080 911 0900



Member of
**Dow Jones
Sustainability Indices**
Powered by the S&P Global CSA